산업통상자원부 「제조업」 르네상스	**보 도 자 료**	정부혁신 보다나은 정부

2019년 8월 27일(화) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 8. 27(화) 오전 6시 이후 보도 가능)

배포일시	2019. 8. 26(월)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박종원 과장(044-203-4270)	담 당 자	김성환 주무관(044-203-4276)

반도체 소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 첫걸음

- 반도체 소재·부품·장비기술 인력양성 사업 출범식 개최 -

□ **산업통상자원부(장관: 성윤모)**는 **8.27(화), 더케이호텔서울**에서 **「반도체 소재·부품·장비기술 인력양성 사업」 출범식을 개최**하였음

< 출범식 개요 >

- 일시/장소 : '19.8.27(화) 11:00~11:50 / 더케이호텔서울
- 참석자 : 유정열 산업부 산업정책실장, 참여대학(6개) 교수, 참여기업(41개) 관계자, 학생, 한국반도체산업협회, 한국산업기술진흥원 등 100여명
- 주요내용 : 사업추진계획 발표, 협약식, 현판수여식 등

□ 금년부터 시작하는 동 사업은 반도체 소재·부품·장비업계가 그간 지속적으로 요청한 **인력양성을 위하여 석사학위과정과 비학위형 단기과정 2가지 트랙으로 운영될 계획임**

○ 석사학위과정은 **산업계 수요를 기반으로 한 교육과정 설계, 참여기업과 산학프로젝트 연계 수행** 등을 통해 졸업 후 즉시 활용가능한 **고급 연구개발(R&D) 인력을 배출**하는 한편,

○ 단기과정은 컨소시엄 기업 재직자, 참여대학 학생 등을 대상으로 **실습설비를 활용한 교육과정**을 운영함으로써 **교육참여자의 실무능력 제고를 지원할 계획**임

□ 사업 주관기관인 반도체산업협회는 사업수행을 위해 **6개 대학, 41개 중소·중견기업으로 컨소시엄*을 구성함**

* 대학 : 명지대, 성균관대, 인하대, 충남대, 한국기술교육대, 한국산업기술대
기업 : 버슘머트리얼즈코리아, 이엔에프테크놀로지, 이오테크닉스, 피에스케이, 테스, 에이피에스(APS)홀딩스 등 41개 기업

○ 참여 대학은 관련 분야 인력양성 경험과 실적을 보유한 대학으로, 특히 **학부생 대상 반도체장비 전공트랙*과정을 운영 중**인 **대학을 중심으로 구성**하여 **학부에서 석사까지 교육과정을 연계**

* (사업기간) '17~'21, (참여대학) 명지대, 인하대, 한국산업기술대
(예산) 연간 약 4.5억, (인원) 연간 40여 명 신규 선발

○ 참여 기업은 대기업에 비해 **상대적으로 인력 수급에 애로가 있는 중소·중견기업으로 구성하여 배출인력이 해당 기업에 연계될 수 있도록 추진**

□ 산업부는 동 사업을 통해 올해부터 향후 5년간, **총 300명(연 60명)의 고급 연구개발 인력 양성을 지원**하여,

○ **국내 반도체 소재·부품·장비산업의 기술 수준 및 기업 경쟁력을 끌어올릴 계획임**

□ **산업부 유정열 실장은 격려사에서** "이번 사업을 통해 양성된 인력이 **반도체 분야 소재·부품·장비산업의 경쟁력을 높이고**, 장기적으로 **반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다**"고 하면서,

○ "정부는 앞으로 반도체 소재·부품·장비기업을 비롯해 **산업 전반에 실무능력을 갖춘 전문인력이 지속적으로 공급될 수 있도록 지원**하겠다"고 밝힘

【붙 임】 반도체 소재·부품·장비기술 인력양성사업 출범식

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 김성환 주무관(☎ 044-203-4276)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 **반도체 소재·부품·장비기술 인력양성 사업 출범식**

□ 사업 배경

○ 국내 소재·부품·장비 기업 경쟁력 강화를 위해 **산업계 수요를 반영한 프로젝트 기반 석사인력양성 사업 시작**

< 사업 개요 >

- 사업명 : 반도체 소재·부품·장비 기술전문인력 양성사업
- 사업기간 : '19.3~'24.2월(5년)
- 사업예산 : '19년 24억원(5년간 120억원)
- 추진체계 : 주관기관(반도체산업협회), 참여기관(명지대, 성균관대, 인하대, 충남대, 산기대, 한국기술교육대 등 **6개 대학** 및 이엔에프테크놀로지, 이오테크닉스, 테스 등 반도체 소재·부품·장비 분야 **41개 기업**)
- 기대효과 : 5년간 총 300명 양성

□ 행사 개요

○ 일 시 : **'19.8.27(화) 11:00 ~ 11:50**

○ 장 소 : **더케이호텔서울 에비뉴 2층 금강홀**

○ 참석자 : 산업정책실장, 학생, 참여대학 교수, 컨소시엄 기업 관계자 등 100여 명

< 세부 일정 >

시간		내용	비고
11:00~11:04	`4	개회 및 참석자 소개	
11:04~11:07	`3	환영사	남기만 부회장
11:07~11:10	`3	격려사	유정열 실장
11:15~11:25	`10	사업 추진 계획 발표	반도체협회
11:25~11:27	`2	학생 선언문 낭독	학생 대표
11:27~11:30	`3	학생 뱃지 수여식(기념촬영)	분과별 학생-기업
11:30~11:50	`20	선언문 협약 및 현판수여식(기념촬영)	산업부, KIAT, 반도체협회, 6개 참여대학

* 동 행사 종료 후 참여대학, 기업과 교류를 통한 네트워크 구축 및 학생을 대상으로 기업설명회 등 워크숍 개최 예정(13:00~15:30)